

# 苏州晶方半导体科技股份有限公司

## 2025年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、前言

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度社会责任报告是根据《上海证券交易所<公司履行社会责任的报告>编制指引》等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。本报告本着真实、客观、透明的原则，系统地总结和反映了公司在履行社会责任方面的实践，旨在真实反映公司2025年履行社会责任的状况，以促进公司全面健康发展。

本报告为公司第十一次向社会发布的社会责任报告，报告范围为2025年1月1日至2025年12月31日。

### 二、公司概况

公司前身晶方半导体科技（苏州）有限公司系经苏州工业园区经济贸易发展局苏园经登字【2005】125号文批准，于2005年6月在江苏省工商行政管理局登记注册的中外合作经营企业。

2010年6月，经苏州工业园区管理委员会苏园管复部委资审【2010】107号文批准，由晶方半导体科技（苏州）有限公司整体变更设立为股份有限公司，并在江苏省工商行政管理局办理了工商登记。

2014年1月，经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2014】50号文核准，公司于2014年2月完成首次公开发行股票并在上海证券交易所上市。

2020年4月，公司2019年年度股东会审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，以方案实施前的公司总股本229,679,455股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），每股派送红股0.2股，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计派发现金红利22,967,945.5元，派送红股45,935,891股，

转增 45,935,891 股，分配后总股本为 321,551,237 股。

2020 年 7 月，公司收到中国证监会出具的《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1514 号）。截至 2020 年 12 月 28 日止，公司共计募集货币资金人民币 1,028,999,666.41 元。公司于 2021 年 1 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份 17,793,527 股的登记托管及限售手续。

2021 年 4 月，公司 2020 年年度股东会审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，以方案实施前的公司总股本 340,064,764 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.235 元（含税），每股派送红股 0.1 股，以资本公积金向全体股东每股转增 0.1 股，共计派发现金红利 79,915,219.54 元，派送红股 34,006,476 股，转增 34,006,476 股，分配后总股本为 408,077,716 股。

2022 年 5 月，公司 2021 年年度股东会审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，以方案实施前的公司总股本 408,257,716 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.283 元（含税），每股派送红股 0.3 股，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 115,536,933.63 元，派送红股 122,477,315 股，转增 122,477,315 股，分配后总股本为 653,212,346 股。

2023 年 5 月，公司 2022 年年度股东会审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，以方案实施前的公司总股本 653,212,346 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发现金红利 45,724,864.22 元。

2024 年 5 月，公司 2023 年年度股东会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，以方案实施前的公司总股本 652,615,226 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.046 元（含税），共计派发现金红利 30,020,300.40 元。

2025 年 5 月，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，2024 年末公司总股本为 652,171,706 股，其中以集中竞价回购产生的库存股 747,700 股，2024 年度利润分配拟以扣除集中竞价回购产生的库存股后的股本 651,424,006 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.084 元（含税），共计派发现金红利 54,719,616.50 元。

公司专注于集成电路先进封装技术服务，为全球最大的新型传感器先进封装技术的开发商和提供商，拥有全球完整的 8 英寸和 12 英寸晶圆级芯片尺寸封装

能力，具备领先的从晶圆级到芯片级封装的一站式综合封装服务能力，拥有全球化的研发、制造及知识产权布局。累计封装了 100 多亿颗各类传感器，包括影像传感芯片、指纹识别芯片、微机电系统芯片、医疗电子芯片等，广泛应用于手机、电脑、身份识别、安防、医疗电子、汽车电子等诸多领域。公司拥有全球化的生产制造与研发中心布局，在苏州拥有两座封装制造工厂，建立了完整的 8 英寸和 12 英寸晶圆级芯片尺寸封装量产线，具备从晶圆级到芯片级封装的一站式综合服务能力；在美国设立了技术研发与 IP 中心，全球知识产权布局超 480 余项；在荷兰拥有光学器件研发和制造工厂，具备领先的精密光学设计、晶圆级光学加工，精密玻璃加工及光学系统模块集成与制造能力；在以色列建立功率模块设计和研发中心，拓展全球领先的第三代半导体-氮化镓器件设计开发能力；在新加坡建立了国际投融资平台，并正在马来西亚槟城推进建设全球化的生产制造基地，顺应新的市场需求与产业趋势。

### 三、社会责任履行情况

#### （一）保护股东和投资者合法权益

公司始终将全体股东权益保护作为经营管理的重要内容，把实现公司及全体股东利益最大化作为经营的重要目标。报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格依照有关法律法规要求规范运作。公司股东会、董事会与管理层之间各司其职、相互制衡、协调运转。公司两会一层的召开、召集及审议决策程序合法有效，各位董事和高级管理人员均勤勉尽责，充分发挥自身专业知识和商业经验，积极参与公司的各项经营决策的讨论分析，认真审议会议议案，审慎发表意见，并实时关注公司经营管理状况，保证了公司各项生产经营活动有序进行，切实维护了公司及全体股东的利益。

##### 1、维护各方权益

晶方科技严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等所适用的法律、法规要求，制定并实施《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关内部管理制度，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露

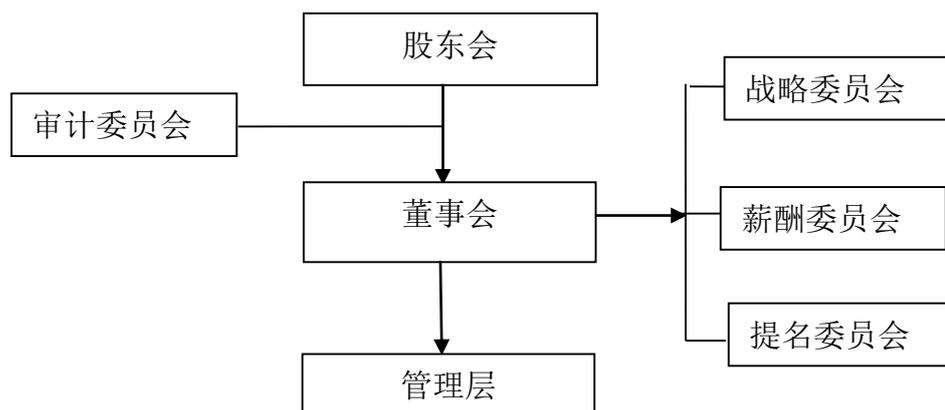
原则，切实履行信息披露义务，不断提升投资者关系管理水平，积极有效地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。公司 2025 年召开的股东会采用现场结合网络投票的方式进行议案表决，并就与中小股东利益密切相关的议案采用中小股东单独计票方式，保护中小股东权益，进一步保障了所有股东特别是中小股东对于公司决策事项的知情权、参与权和表决权。

为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司董事长兼总经理、董事会秘书兼财务总监、独立董事通过上海证券交易所上证路演中心平台于 2025 年 5 月 22 日以网络文字互动的方式召开了 2024 年度业绩暨现金分红说明会，针对公司 2024 年经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。

## 2、两会一层规范运行

公司严格按照《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》召开会议，保证会议召开及审议、决策程序合法合规，确保股东会依法行使职权。

2025 年，公司召开 3 次股东会、6 次董事会、6 次审计委员会，审议了 2025 年度内发生的重大事项，包括财务报告、关联交易、利润分配、购买理财、对外投资、股份回购等，保证了公司两会一层的规范运作与治理水平。



股东会负责规范股东会运行机制，股东会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。

董事会负责召集股东会，执行股东会的决议，向股东会报告工作；决定公司

的中长期发展规划；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预决算方案等。

管理层主持公司的生产经营管理工作，研究贯彻上级重大决策部署的重大经营管理事项，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案等。

### 3、注重股东收益回报

《公司章程》中明确规定了较为稳定、合理的利润分配政策，公司董事会根据公司年度经营业绩制定利润分配方案，提交股东会审议。

2025年5月16日召开的2024年度股东会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，2024年末公司总股本为652,171,706股，其中以集中竞价回购产生的库存股747,700股，2024年度利润分配拟以扣除集中竞价回购产生的库存股后的股本651,424,006股为基数，向全体登记股东每10股派发现金红利0.84元人民币（含税），实际分配现金利润为54,719,616.50元人民币，占本年度归属上市公司股东净利润的21.65%，并已于2025年5月4日实施完毕。

公司召开的第六届董事会第二次会议审议了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，2025年末公司总股本为652,171,706股，其中库存股747,700股，2025年度利润分配拟以扣除库存股后的股本651,424,006股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计人民币78,170,880.72元。上述议案经第六届董事会第二次会议通过后提交股东会审议。积极持续的现金分红与股利分配切实保障了股东的收益权与投资回报。

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（元）（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2025年	-	1.20	-	78,170,880.72	368,077,301.52	21.15
2024年	-	0.84	-	54,719,616.50	252,758,312.83	21.65
2023年	-	0.46	-	30,020,300.40	150,095,690.43	20.00

### 4、内幕信息的管理

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》，建立了内幕信息知情人档案，严格履行内幕信息登记、报备程序，保证了内幕信息登记管理工作的有序开展。近年来，公司内幕信息管控有效，没有出现违规事项。

#### 5、认真履行信息披露义务

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，持续完善公司信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，提升公司信息披露质量。公司积极履行信息披露义务，并就有关事项及时与监管部门进行沟通，保证信息披露的及时、准确、完整。报告期内，公司通过指定信息披露媒体发布 4 份定期报告和临时公告文件 36 篇，充分披露了可能对公司股票价格产生重大影响各类重大信息。公司披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何违反信息披露相关规定的情形，提高了公司的透明度，保障了投资者的知情权。在履行信息披露义务过程中，未发生实行差别对待，或有选择地向特定对象披露、透露、泄露非公开信息的情况，使广大投资者公平享有知情权。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为信息披露媒体。

#### 6、积极开展投资者关系管理工作

2025 年，公司依据监管要求和业务发展需要组织了多种形式的投资者交流活动，公司通过日常沟通、网络平台等多种渠道，进一步加强了与投资者的交流互动。公司采取接听电话、接待投资者来访、外部网站、微信公众号、e 互动平台等多种形式加强与投资者的交流与沟通，回答投资者的问询，听取投资者的建议和意见，并认真做好投资者来访调研接待工作，使公司股东及潜在投资者准确、全面地了解公司整体运营情况。

### **（二）积极维护员工权益**

公司重视员工权益，在企业发展中关注员工成长，关心员工生活，建立完善的薪酬体系与职业发展通道，搭建多元化学习平台，倡导人文关怀，丰富职业文体生活，切实保障员工权益，为员工的职业生涯创造良好的发展空间。

#### 1、切实维护员工合法权益

企业的发展，离不开员工的辛勤付出。公司始终重视员工价值的重要性，把为员工提供平台作为企业使命，通过多种措施保障员工的合法权益，促使员工认

同公司的企业文化，以成为晶方人而自豪。

根据公司发展战略，结合市场薪酬状况及公司实际情况，建立和完善岗位用人标准和薪酬体系。并根据职能部门的不同，制定不同的绩效考核办法，以激发员工的积极性和创造性。

公司深谙人文关怀之重要性，倾力于员工精神文化生活的培育，致力追求每一位员工职场幸福感与满意度的提升。为使员工在繁忙工作之余亦能领略家的温馨，公司主动构筑多元互动平台，不定期举办一系列精彩纷呈的活动，涵盖团队建设、庆典盛会、文体竞技等，旨在让员工于轻松愉悦的氛围中舒缓压力，从而增强其对职场的幸福感与归属感。公司工会紧紧围绕企业中心任务，充分发挥工会组织作用，积极履行工会职能，团结员工迎难而上，奋力拼搏。2025年，在体育竞技方面，工会积极组织篮球赛、足球赛等多项竞技比赛。公司内，第十五



届“晶方杯”篮球赛火热开打，不同事业部门的六支队伍在比赛中大显身手。

2025“晶方杯”于2025年11月火热开打，晶方员工在比赛中既为自己而战，也为部门团队而战。11月29日下午，2025“晶方杯”羽毛球赛在产业园羽毛球场圆满落幕，职能部门联队在多名来总部培训的马来西亚同事的助阵下，如愿夺得团体追逐赛冠军。在27日晚上提前进行的男、女单打决赛中，亦决出了男单与女单冠军。



在文娱活动方面，工会组织开展迎新美食节、部门团建、露营野餐亲子游以及宿舍欢聚元旦等活动，在闲暇时刻为员工提供精彩丰富的娱乐活动，增加了员工与亲子的陪伴时间，营造劳逸结合的良好氛围，为员工投身公司的生产经营提供了动力，实现了企业与员工的和谐发展。



## 2、为员工提供充分的社会保障

公司为员工免费提供宿舍、足额缴纳“五险一金”，建立并认真执行员工带薪年假制度，根据国家规定充分保障女性员工在怀孕、生产、哺乳期间所享有的待遇。公司为吸引和留住人才，改善宿舍楼住宅环境、优化调整班车路线，不定期地组织活动丰富业余生活，使员工尽快融入公司大家庭。每年评选优秀员工、优秀班组及优秀宿舍等奖项，并给予表彰及奖品；每年组织全体员工进行体检，以确保员工的身心健康。



### 3、为员工职业发展提供广阔空间

公司高度重视员工职业发展,通过业务培训等方式,从业务技能、专业知识、精益管理等多方面加强员工培训,更新观念、转变态度、学习技能,不断提升员工综合素质和工作能力,为员工职业发展创造良好的环境。

公司为员工设计和规划了管理和专业技术两个发展通道,让员工在发展上不受局限;公司还设立了内部招聘通道,使具备相应能力的员工可以争取更好的职业发展。

### 4、关注员工生活,营造和谐企业文化

2025年,面对日益严峻的行业形势和激烈的市场竞争,公司经营环境充满挑战。尽管如此,公司始终秉持“以人为本”的理念,竭尽全力做好各项工作,努力为员工创造更好的工作与生活环境。公司不仅按时发放年终奖金,还组织全体员工进行健康体检,关注员工的身心健康。同时,公司积极协调班车路线,优化通勤安排,方便员工上下班,切实解决员工的实际困难。此外,公司加强对员工的慰问关怀,注重倾听员工诉求,从细节入手,让每一位员工都能感受到公司的温暖与关怀,进一步增强员工的认同感和归属感。

在硬件设施方面,公司对员工宿舍、办公区域及厂区环境进行了全面的维修与维护,持续优化厂区绿化环境,打造“花园式”厂区。不仅提升了公司的整体形象,也为员工创造了更加舒适、整洁的工作与生活环境,进一步增强了员工的幸福感和凝聚力。



晶方科技坚持以人为本的思想，推行晶方“家文化”，做优“幸福晶方·温馨之家”，做实“有为晶方·奋进之家”，做好“和谐晶方·满意之家”。在文化

活动方面，公司定期举办形式多样、内容丰富的活动，旨在提升员工的参与感与归属感。每年年终之际，公司召开总结表彰大会，表彰优秀员工和先进团队，并举办精彩纷呈的文艺演出，展现出员工的多才多艺和积极向上的精神风貌。此外，公司还组织员工团建休闲活动，增强团队协作能力；迎新美食节则为员工提供了在美食与欢笑中迎接新年的机会。工会积极组织各部门参加足球、篮球等竞技比赛，丰富员工的业余生活的同时也增强了团队凝聚力。



在员工关怀方面，公司在重大节日为员工发放福利，并在员工生日时送上蛋糕和礼物，让员工感受到公司的贴心与温暖。通过这些举措，员工的生活变得更加多样、充实和丰富，进一步提升了员工的幸福感和满意度。

公司始终将员工视为最宝贵的财富。为感谢员工的辛勤付出并促进团队融合，我们精心策划年度海外旅游活动，帮助员工在开拓视野、放松身心的同时，也深化彼此的理解与协作。这不仅是公司关爱文化的重要体现，更是我们践行雇主责任、提升员工幸福感与归属感的切实行动。我们相信，快乐的团队能创造更大的价值，并与公司共同成长。



公司定期组织的各类文体活动深受广大员工的欢迎。员工通过参与文体活动和文娱表演，不仅展现了自身的才华与活力，也体现了公司积极向上的企业文化。这些活动不仅加强了员工之间的交流与沟通，还进一步提升了公司的凝聚力和向心力，展现了晶方人团结奋进、乐观向上的精神风貌。未来，公司将继续致力于为员工创造更好的工作与生活环境，推动企业与员工共同成长，携手迈向更加美好的明天。

### （三）保障客户及供应商权益

公司以客户需求为导向，持续提升产品质量与服务，追求与客户协调发展，不断提高客户满意度。公司与战略客户维护良好合作关系的同时，开发新的战略客户，加强与客户沟通，确保公司健康发展，与客户建立互相信任，合作共赢的战略联盟。优化生产方式、提升产品品质，以品质、经营、效率、生产为主线，建立生产单位评价机制。以精益思想为指导，全面提升公司产品的质量，切实做到在产品品质上与对手差异化，维持并提升我们的品牌效应。

公司通过多种渠道征集客户意见，发掘和满足客户需求，为自身和社会创造经济效益和社会效益。公司将客户视为长期战略合作伙伴，长期共存、精诚合作、相互信任、共同成长。报告期内，公司不断提升产品质量，优化运作架构，提升服务能力，做好细分市场，努力为客户提供高品质的半导体集成电路产品。

2025 年公司整体业绩保持健康增长的态势，为了更好地与产业生态互动，有效提升市场对公司技术和业务的认知，公司积极参与多种形式的行业活动。2025 年，公司在行业多个主题会议发表主题演讲，包括中马科技产业合作峰会，纳博会，ICEPT 电子封装国际研讨会，MEMS 智能传感器产业发展大会，MEMS 标委会，封测联盟年会等。同时公司通过媒体采访，品牌评比等活动向公众展示公司良好的发展前景。同时，公司也积极与新闻和电视媒体互动，通过公开交流渠道，一方面展示了公司在新的年度的发展规划和技术前景，一方面也听取了供应链对于加强合作的期望和意愿，为建立互相信任，相互支持，共同发展的合作模式提供推动作用。

公司一直坚持“共赢”原则，与供应商共同成长。积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商的合法利益，建立了公平、公正的评估体系，在公平公正、充分竞争的基础上择优选择供应商，保证采购成本

和质量的控制。

公司规范供应商管理，选择优秀的供应商作为供应链的合作伙伴，建立双方长期的战略协作关系，公司坚持平等协商、互利共赢的原则，建立统一的供应商管理体系以及公平、公正的供应商评价体系，为供应商提供良好的竞争环境。

#### （四）做好安全节能生产、推进绿色持续发展

公司高度重视环境保护建设，积极实施节能降耗方案。员工牢固树立环保意识，严格控制生产经营过程中的能源耗用，抓好生产全过程，充分利用各种资源，杜绝浪费，公司连续五年被评为工业企业资源集约利用综合评价 A 级企业。

公司坚持环境保护，低碳、绿色发展，积极实施资源能源再利用，建立了 ISO14001 环境管理体系和 ISO50001 能源管理体系；严格落实排污许可制度，规范开展自行监测，严控污染排放；按照全生命周期管控固废；开展土壤监测，实现信息化管理。

公司认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产年度总要求，以安全生产标准化建设为抓手，以落实安全生产责任、强化安全生产意识、开展隐患排查为着力点，实施全年安全生产管理工作，强化系统安全，认真开展安全生产各项工作。



公司制定了全面的安全管理制度来保证安全管理的落实，每月组织一次安全检查，发现隐患及时整改；生产车间每周检查一次，并将安全指标责任纳入年终考核。

在生产岗位的员工正式进入生产岗位前，将进行岗前安全及操作培训，经过理论及实际操作考核合格后才能正式上岗作业。对于特种设备操作人员由公司安排到专门培训机构进行培训，考核合格才允许上岗作业。公司还建立了重要节假

日和敏感时期的安全值班备勤制度，组织灭火实操演练、消防逃生疏散演练等活动提高全体员工的安全意识和自我防护能力，员工安全教育培训率达 100%。

公司极为重视安全生产和劳动保护，成立安全委员会及 EHS 部门，建立严格的安全生产检查制度和安全生产管理网络。在各级管理人员和各部门的努力下，报告期内，公司无重大人员伤亡事故、无重大设备事故、无火灾爆炸事故、无重大交通事故、无职业病事故，为企业顺利完成各项任务提供了一个良好的安全生产平台。

### **（五）技术创新与研发人才**

作为国内车载 CIS 芯片封测领域的领军企业，晶方科技一直致力于集成电路先进封装技术的研发与服务。公司在高端芯片封装测试技术创新方面持续加大投入，报告期内不断对工艺流程进行优化升级，确保产品性能在国内保持领先水平。

集成电路先进封装行业是典型的技术密集型、人才密集型行业。专业水平高、技术实力强的研发团队是公司持续创新能力的软实力保证。公司积极响应国家激励政策，通过激励机制激励研发人员自主创新，实施研发成果奖励机制，调动员工创新积极性。公司进一步构建和完善导向鲜明的荣誉体系，为公司持续创新能力提供保障。截至报告期末，公司研发团队总人数为 259 人，占公司总人数的 23.81%，公司研发投入 15,311.89 万元，占营业收入的 10.88%。

### **（六）服务社会与创新进取**

公司在保持企业发展的同时，不忘回报社会，构建良好的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情况下，积极参加社会活动，共同维护社会和谐稳定。

2025 年，公司作为牵头单位积极推进国家重点研发计划“智能传感器”重点专项—“MEMS 传感器芯片先进封装测试平台”项目的实施，项目目前各项任务有序开展，积极准备项目终审，各项任务指标正在有效推进完成。公司针对高端 MEMS 传感器先进封装测试需求，突破共性关键技术、形成成套先进封装工艺，并努力推进相关技术工艺的产业化应用；公司承担市重大科技成果转化揭榜挂帅“汽车芯片高密度高可靠性晶圆级封装技术研发及产业化”，针对车用高可靠性高密度智能传感器芯片开发的先进晶圆级封装技术。

公司积极发挥“苏州市产业技术研究院车规半导体产业技术研究所”的平台

资源，引入、孵化与培育研发团队，围绕车规半导体先进封装技术、智能光学照明、功率半导体等方向，展开新工艺、新材料、新设备的开拓布局，构建产业生态链，以期能更好把握汽车产业智能化，电动化和网联化带来的新发展机遇。

公司与苏州大学签署合作协议，共同成立苏州大学晶方科技微纳封测与智能系统创新技术研究院，进一步深化名城名校融合发展，推动产业创新。公司同苏州大学机电工程学院通过科研资源、产业资源的协同整合与互补，进一步推进合作的深度与广度，从而加快科研资源与成果的商业化。围绕企业需求，共同组织实施产业关键核心技术攻关项目，破解“卡脖子”技术难题，形成具有原创性、引领性、核心竞争力的新技术和新产品；以需求为牵引，凝炼和解决创新链、产业链双链融合重大问题，解决企业在研发、生产、售后等各环节中遇到的技术问题。



2025 年，公司进一步加强税务基础管理，降低税务风险，提高全员纳税意识，提升税务工作合法、合规性，并为支持地方经济的发展做出经济贡献。公司 2025 年度纳税信用等级为 A 级。

#### 四、结语

时光荏苒，岁月如梭。2005-2025 年，晶方已经走过了 20 周年，创业风雨 20 载，归来依然是少年，全体晶方人辛勤付出书写出辉煌璀璨的奋斗篇章；展望 2026，晶方仍将秉持“快速试错、快速迭代成长”的研发创新精神为芯片封测行业提供晶方方案、展示晶方能量。我们正奔赴下一个十年的“芯”征程，续写“芯”篇章。自公司成立至今，我们始终秉持着对社会、环境和企业自身责任的深刻认知，将 ESG（环境、社会和公司治理）理念贯穿于公司发展的每一个环节，致力于实现可持续发展的长远目标。同时，我们积极拥抱新质生产力，以芯片封装测试为核心，推动企业向高科技、高效能、高质量方向发展，为数字中国建设贡献

“芯”力量。

展望未来，公司将继续完善社会责任管理，在提高企业经济效益的同时，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，积极回报股东、保护员工的合法权益。同时，积极参与社会公益事业和生态环境保护，提高资源利用率，进一步强化社会责任意识，健全社会责任管理体系建设，我们将深入贯彻晶方科技“ESG 可持续发展”理念，与供应商及合作伙伴携手推动供应链的低碳转型，共建可持续发展生态体系，助推经济社会的可持续发展。在更多的领域更好地承担和履行企业的社会责任，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2026年2月27日